

# 沈阳富创精密设备股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告

### 暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心，于 2025 年 4 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年度（以下简称“报告期”），公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将报告期内的主要工作成果报告如下：

#### 一、 专注公司主营业务，提升核心竞争力

根据 SEMI 在 2025 年 12 月发布的《年终总半导体设备预测报告》，2025 年全球半导体制造设备总销售额达 1,330 亿美元，创历史新高，同比增长 13.7%；刻蚀、薄膜沉积等前道核心设备需求随先进逻辑、存储产线扩产大幅提升，预计 2026 年、2027 年全球半导体制造设备销售额将继续攀升至 1,450 亿美元、1,560 亿美元。在全球半导体制造设备总销售额持续增长、行业国产替代进程加速的行业背景下，公司凭借超高的产品配套覆盖率、先进制程的优势产品及大客户服务战略，进一步稳固了国内半导体设备精密零部件领军企业的行业地位。

在 2025 年，公司依托“十四五”构建的产品矩阵与技术壁垒，深度契合国家关键核心技术攻关部署。报告期内，公司以“四化”为核心路径，推进能力升级，聚焦先进制程新增五大专项，形成全产品矩阵，彰显行业龙头的创新担当与产业价值。

报告期内，公司在集成电路装备零部件领域接连斩获国家级重磅荣誉，技术实力与行业标杆地位获得权威认可。公司获评“国家制造业单项冠军企业（集成电路设备金属零部件）”，核心技术水平与全球市场占有率实现双重提升，由国内领跑迈向全球领军；同时荣获“国家卓越级智能工厂”，建成国内人工智能赋能的集成电路装备零部件精密制造标杆工厂，实现从传统制造向高端智造的转型升级。此外，公司获批承担“国家数字化专项”，以数字化推动集成电路零部件制造智能化升级，持续夯实精密制造核心竞争力；获批牵头承担“国家制造业\*\*专

项（L 材料）”与“国家制造业\*\*专项（Y 材料）”，联合产业链上下游开展协同攻关，突破半导体设备关键材料国产化技术瓶颈。

在国家重大专项方面，公司与客户联合承担的 2 项国家专项顺利通过验收，相关产品经先进制程验证实现批量供货，在客户面临断供风险时有效保障产线稳定运行，筑牢国家集成电路产业供应链安全根基。南通富创亦成功获批首批国家专项，进一步提升公司智能制造与数字化发展水平。

报告期内，公司依托平台化与智能化的协同布局，系统提升对全球半导体设备龙头企业的综合服务能力。通过技术升级与产品创新，市场竞争力持续增强，业务规模持续扩张，2025 年实现营业收入 35.43 亿元，同比增长 16.58%。报告期内，核心客户合作黏性持续增强，公司前五大客户营收占比合计达 70%以上。

在业务拓展方面，气体传输系统作为公司重点培育的第二增长曲线，实现了较为明显的增长态势。2025 年度，该板块实现营业收入 11.06 亿元，较上年同期增长超过 25%，市场份额稳居国内领先地位，展现出强劲的发展动能与市场竞争优势。

2026 年，公司将以大平台为基地，推动标准化体系、技术规范与生产流程的全球一体化，实现境内外研发、制造与服务的高效衔接，为半导体设备关键零部件本土化供应提供坚实支撑。对内持续巩固技术研发与精益管理能力，对外深化全球客户协作与产业链资源整合，一方面强化国内半导体设备厂商配套服务能力，另一方面积极拓展海外高端市场；在巩固传统精密零部件业务优势的基础上，以五大产品专项为抓手培育新增长极，通过战略投资、并购重组强化上下游协同，提升关键工艺与产品自主化水平，助力半导体产业链自主可控。同时，公司将同步推进品牌矩阵构建，以极致的产品质量筑牢品牌根基——秉持“零缺陷”的品质标准，打造高认可度的产业品牌，实现品牌价值与产业竞争力的双重提升。

## 二、 加快发展新质生产力，创新配置生产要素

中国作为全球半导体产业链的重要市场，报告期内持续带动本土设备产业创新升级，国内设备企业加快核心技术攻关与国产化替代。公司作为半导体设备精密零部件领域的领军企业，围绕技术创新与产品迭代实现多项关键突破：

在技术研发方面，一是攻克 CMP 抛光盘加工瓶颈，相关重点客户市场份额提升；其二是自主研发超临界清洗腔体，实现微米级加工精度，目前为国内独家

供应；三是建成国内领先的镀金能力，反射率已达国内领先，产品通过客户认证并已获订单。

在匀气盘先进产品领域，公司针对国际厂商长期主导格局，针对性在 2025 年完成多款集成化产品开发，多流道复杂焊接加热匀气盘、陶瓷喷涂匀气盘、复杂结构 3D 纳米镀膜匀气盘均通过 7nm 以下先进制程终端验证并实现量产交付。多流道复杂焊接加热匀气盘应用于先进逻辑、先进存储的化学反应刻蚀工序，有效提升客户良率。陶瓷喷涂匀气盘集成小孔遮蔽、高洁净清洗、R 角喷涂等复杂工艺，实现全流程自主生产与表处量产高稳定性，突破行业高端制造瓶颈。3D 纳米镀膜匀气盘实现 ALD 设备量产应用并提供翻新服务。2025 年，公司部分大客户的匀气盘订单同比分别增长 79%和 156%，交叉孔焊接、螺旋槽斜孔匀气盘实现规模化推广。

在金属加热盘领域，公司突破海外技术壁垒，相关产品通过国内外头部设备厂商认证并实现国产化替代，成为其核心供应商。铝合金加热盘实现多款规模化生产；不锈钢加热盘实现多型号小批量生产，产品已应用于 PECVD、Strip ETCH 等核心机台，公司在报告期内持续推进先进制程产品开发验证，自主技术与产品竞争力持续增强。

在真空阀门领域，公司聚焦国内头部厂商痛点开展定制化研发与国产化替代，完成基于 L-motion、J-motion 机理三个位置的阀门产品开发，并搭建专用测试体系，实现贴近机台实际工况的全维度验证。2025 年，公司多款阀门完成客户端验证并获得小批量订单。公司通过与客户研发端深度协同，实现按需定制开发，阀门研发将持续向机台前端需求延伸。

除此外，公司在表面处理特种工艺领域构建了差异化技术优势，在耐蚀涂层方面，自主研发的“致密 YO 涂层”于 2025 年完成国内头部客户首件认证并快速量产；同年下半年完成“超高致密 YO 涂层”开发，膜层孔隙率<1%，抗腐蚀性能显著提升，目前已陆续进入头部客户验证阶段。在纳米薄膜技术方面，公司开发的“N 系列膜层、O 系列膜层”实现全面量产交付，其中“O 系列膜层”凭借高洁净度控制及优异耐腐蚀性能通过头部客户认证并批量应用，已被推荐至多家国内半导体设备龙头企业，认证进展顺利；“N 系列膜层”在报告期内斩获并交付近千万级订单，技术优势持续转化为市场增量。

随着先进制程对耐高温、粒子控制及金属污染抑制要求的指数级提升，公司表面处理技术的性能壁垒将进一步增厚，为国产半导体设备突破更先进逻辑芯片制造瓶颈提供底层工艺支撑。

2026年，公司将持续加大研发投入，重点突破7纳米及5纳米先进制程设备零部件的核心技术，拓展高附加值产品品类，重点发力加热盘、阀门产品的市场落地与产能释放；静电卡盘专项制定3-5年长期发展规划，稳步推进技术突破、客户验证与产业化落地。同时将持续加大在原材机理、等离子反应原理、新型表面处理技术、贴近应用场景的实验和检测平台搭建等方面的研发投入，为中国半导体生态全面向先进制程迈进贡献力量。

### **三、 积极保障投资者权益，统筹规划业绩与回报的动态平衡**

#### **1、 权益分派**

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。报告期内，公司以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利45,681,688.2元（含税）。上述利润分配已在2025年7月17日派发完毕。

#### **2、 回购股份注销**

2025年3月11日公司披露《关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011），公司注销回购专用证券账户中的部分股份1,817,224股，占注销前股份总数的0.5900%，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报。注销完成后，公司总股本由308,027,995股变更为306,210,771股，注册资本由人民币308,027,995元变更为人民币306,210,771元。

未来，公司仍将结合业务现状以及未来发展规划，统筹规划公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》利润分配政策的前提下，维持并努力提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### **四、 完善与投资者沟通机制，夯实资本市场发展基础**

报告期内，公司积极接听投资者专线、回复“上证E互动”平台提问，在“上证路演中心”、“进门财经”平台举办业绩说明会。

除业绩说明会外，公司通过线上及线下方式接待投资者交流，持续与资本市场沟通公司经营管理状况、产品技术、产能建设等相关信息，充分保护投资者合法权益。2025年6月，公司参与同花顺联合东海证券组织的“我是股东”走进上市公司活动，活动汇聚了来自全国各地的产业专家，行业专家、机构投资者，此次活动一方面向投资者展示了公司良好形象，一方面也为公司、机构、产研之间架起沟通桥梁，搭建起高效能、高质量的交流平台。

2025年12月，公司组织举办首届投资者开放日活动。活动由公司部分董事、高管以及相关业务领导全程参与，通过组织投资者实地探访北京智能工厂，全面展示了公司在精密制造领域的核心技术、智能化产线以及未来的战略布局。在交流环节，管理层与核心投资者就行业趋势、公司发展规划等议题进行了深入沟通。增强投资界对公司技术实力与发展路径的了解，也提升公司在资本市场透明度。

2026年，公司将持续参与国际专业展会，加大数字化营销、内容营销与全球化品牌传播投入，全面提升公司品牌在全球半导体领域的知名度，打通渠道资源、客户资源、产品资源共享机制，实现全球销售体系高效联动。公司将继续关注股东诉求、重视资本市场，严格遵循法律法规及监管要求，依照公司《投资者关系管理办法》积极展开投资者交流活动并及时履行信息披露义务。

## **五、 持续完善公司治理，提升规范运作水平**

在三会运作方面，公司在报告期内共召开股东（大）会7次，董事会8次，发挥了董事会、各专门委员会、独立董事的各项职能。

未来，公司仍将践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展。

## **六、 进一步改进措施**

未来，公司将持续评估行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，并将继续专注主业，通过良好的盈利能力、经营质量和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2026年4月30日